

台灣世曦工程顧問股份有限公司獎學金契約

立契約人

台灣世曦工程顧問股份有限公司（以下簡稱甲方）

錄取者：_____（以下簡稱乙方）

雙方同意訂立契約條款如下：

第 1 條 依甲方獎學金辦法訂定。

第 2 條 甲方提供乙方下列項目：

在學期間獎學金，每學期補助新台幣五萬元，以____學期為限(最高為____萬元)。

第 3 條（乙方姓名、系級、領取獎學金起迄及金額）

姓名：

校名：

科系：

年級：

自____學年度第____學期起至____學年度第____學期止，共計____學期，獎學金合計____萬元。

第 4 條（權利與義務）

一、乙方除申請的第一學期外，每學期需檢附前一學期之成績單及本學期在學證明，於開學一個月內提交，甲方視成績優劣續發、終止或追償獎學金。

二、乙方應於畢業或役畢後二個月內至甲方任職，凡領一次獎學金者，須服務半年，而後每增領獎學金一次則延長服務期間半年，依此類推，請領次數最多以四學期為限，即服務義務年限為二年。

三、甲方得依公司整體發展方向及業務需求，參酌乙方專長進行任職部門分發，乙方應接受分發結果。

四、乙方薪資與職等依甲方相關規定辦理。

五、乙方應於第3條所訂期間內(以下稱「修業年限」)取得碩士畢業證書。

六、乙方若未能於前述規定之修業年限取得碩士畢業證書，應於修業年限屆滿前，向甲方提出延後畢業之書面說明。如未於修業年限前提出書面說明，或提出書面說明未經甲方同意者，甲方即停止發給獎學金，並追償已領取之獎學金。

第 5 條（獎學金追償）

一、乙方如有下列情事，喪失領取獎學金之資格，甲方即停止發給獎學金，並追償已領取之獎學金。所衍生之相關稅款由乙方自行負擔。但有特殊情形，經甲方同意者，不在此限。

(1)申請保留學籍、延畢者。

(2)在學中途轉學、休學、退學或被學校記小過以上之處分。

(3)申請文件內容虛偽造假且經查證屬實者。

- (4)領取其他具服務義務之獎學金或負有服務義務者(如研發替代役)。
- (5)畢業後(含役畢)二個月內未至甲方任職。
- (6)未能完成服務義務者,須按不足年限比例歸還。
- (7)違反法律且經判刑確認為。

二、乙方如有下列情事之一者,得免追償獎學金。

- (1)因意外事故或疾病因素導致傷亡或肢體、心神遭受損害,經醫生判定無法勝任甲方工作者,免於追償已領取之獎學金。
- (2)甲方無人力需求時,得於畢業(或役畢)三個月前通知乙方取消履行服務義務。

第6條 (送達)

除本契約另有約定外,應送達本契約當事人之通知、文件或資料,均應以中文書面為之,並於送達對方時生效。除於事前取得他方同意變更地址者外,雙方之地址應以下列為準:

一、甲方公司地址:台北市內湖區陽光街323號

二、乙方戶籍地址:

當事人之任一方向未依前項規定辦理地址變更,他方按原址,並依當時法律規定之任何一種送達方式辦理時,視為業已送達對方。

前項按址寄送,其送達日以掛號函件執據、快捷執據或收執聯所載之文寄日期視為送達。

第7條 (管轄)

本契約的雙方應依誠信原則確實履行,如有涉訟,以臺灣臺北地方法院為管轄法院。

第8條 (契約份數)

本契約一式二份,經雙方當事人簽章後生效,甲乙雙方各收執一份。

立契約人:

甲方:台灣世曦工程顧問股份有限公司

代表人:

地址:台北市內湖區陽光街323號

電話:(02) 8797-3567

乙方:

國民身分證統一編號:

地址:

電話:

中華民國 年 月 日

【附件二】

台灣世曦工程顧問股份有限公司獎學金契約

立契約人

台灣世曦工程顧問股份有限公司(以下簡稱甲方)

錄取者: (以下簡稱乙方)

雙方同意訂立契約條款如下:

第1條 依甲方獎學金辦法訂定。

第2條 甲方提供乙方下列項目:

在學期間獎學金,每學期補助新台幣五萬元,以 學期為限(最高為 萬元)。

第3條 (乙方姓名、系級、領取獎學金起迄及金額)

姓名:

校名:

科系:

年級:

自 學年度第 學期起至 學年度第 學期止,共計 學期,

獎學金合計 萬元。

第4條 (權利與義務)

一、乙方除申請的第一學期外,每學期需檢附前一學期之成績單及本學期在學證明,於開學一個月內提交,甲方視成績優劣續發、終止或追償獎學金。

二、乙方應於畢業或役畢後二個月內至甲方任職,凡領一次獎學金者,須服務半年,而後每增領獎學金一次則延長服務期間半年,依此類推,請領次數最多以四學期為限,即服務義務年限為二年。

三、甲方得依公司整體發展方向及業務需求,參酌乙方專長進行任職部門分發,乙方應接受分發結果。

四、乙方薪資與職等依甲方相關規定辦理。

五、乙方應於第3條所訂期間內(以下稱「修業年限」)取得碩士畢業證書。

六、乙方若未能於前述規定之修業年限取得碩士畢業證書,應於修業年限屆滿前,向甲方提出延後畢業之書面說明。如未於修業年限前提出書面說明,或提出書面說明未經甲方同意者,甲方即停止發給獎學金,並追償已領取之獎學金。

第5條 (獎學金追償)

一、乙方如有下列情事,喪失領取獎學金之資格,甲方即停止發給獎學金,並追償已領取之獎學金。所衍生之相關稅款由乙方自行負擔。但有特殊情形,經甲方同意者,不在此限。

(1)申請保留學籍、延畢者。

(2)在學中途轉學、休學、退學或被學校記小過以上之處分。

(3)申請文件內容虛偽造假且經查證屬實者。

四、證件影本

請黏貼身分證正面影本	請黏貼身分證反面影本
請黏貼學生證正面影本	請黏貼學生證反面影本

1. 本人茲聲明上述填寫資料及附件資料均屬實,如有不實,願負法律責任。
2. 本人已詳閱台灣世曦工程顧問股份有限公司獎學金辦法,了解本人依本辦法申請獎學金,將於簽訂獎學金契約後負有依約履行之義務,且願意遵守相關規定。
3. 本人切結未受領其他有約定附帶服務義務之獎學金。
4. 本人同意台灣世曦工程顧問股份有限公司查核與本獎學金申請之任何有關資料。
5. 本人同意台灣世曦工程顧問股份有限公司得基於獎學金申請、審核等相關作業之目的,於符合個人資料保護相關法令之規定下,為蒐集、處理及使用本人所提供之個人資料。
6. 本人同意本次申請文件作為獎學金查核、審核與核發之依據,且概不退件。

申請人: (簽名) 中華民國 年 月 日

【附件一】

台灣世曦工程顧問股份有限公司獎學金申請表

一、申請人基本資料	
中文姓名:	英文姓名:
身分證字號:	出生年月日:
現就讀學校:	系所/組別:
畢業大學:	科系:
兵役情形: <input type="checkbox"/> 女性免役 <input type="checkbox"/> 已服役 <input type="checkbox"/> 未服役 <input type="checkbox"/> 免役(請附證明)	
戶籍地址: □□□	
通訊地址: □同上□□□□	
E-mail:	
電話:	手機:
曾於本公司實習: <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 部門: 實習期間: 年 月 日 至 年 月 日	
二、推薦教授	
姓名:	系所戳章
任職學校:	
職稱:	
聯絡電話:	
三、申請文件檢核表	
<input type="checkbox"/> 個人簡歷/自傳 <input type="checkbox"/> 在學證明正本乙份 <input type="checkbox"/> 成績單正本乙份(研究所/大學歷年)	
<input type="checkbox"/> 操行成績(獎懲紀錄) <input type="checkbox"/> 語文能力證明 <input type="checkbox"/> 證書、競賽、專題報告或學術研究等相關資料	
<input type="checkbox"/> 教授推薦信 <input type="checkbox"/> 身份證正反面影本 <input type="checkbox"/> 學生證正反面影本	
<input type="checkbox"/> 其他有利於審查之文件: _____	

四、證件影本	
請黏貼身分證正面影本	請黏貼身分證反面影本
請黏貼學生證正面影本	請黏貼學生證反面影本
1. 本人茲聲明上述填寫資料及附件資料均屬實，如有不實，願負法律責任。 2. 本人已詳閱台灣世曦工程顧問股份有限公司獎學金辦法，了解本人依本辦法申請獎學金，將於簽訂獎學金契約後負有依約履行之義務，且願意遵守相關規定。 3. 本人切結未受領其他有約定附帶服務義務之獎學金。 4. 本人同意台灣世曦工程顧問股份有限公司查核與本獎學金申請之任何有關資料。 5. 本人同意台灣世曦工程顧問股份有限公司得基於獎學金申請、審核等相關作業之目的，於符合個人資料保護相關法令之規定下，為蒐集、處理及使用本人所提供之個人資料。 6. 本人同意本次申請文件作為獎學金查核、審核與核發之依據，且概不退件。	
申請人：_____ (簽名) 中華民國_____年_____月_____日，	

四、證件影本	
請黏貼身分證正面影本	請黏貼身分證反面影本
請黏貼學生證正面影本	請黏貼學生證反面影本
1. 本人茲聲明上述填寫資料及附件資料均屬實，如有不實，願負法律責任。 2. 本人已詳閱台灣世曦工程顧問股份有限公司獎學金辦法，了解本人依本辦法申請獎學金，將於簽訂獎學金契約後負有依約履行之義務，且願意遵守相關規定。 3. 本人切結未受領其他有約定附帶服務義務之獎學金。 4. 本人同意台灣世曦工程顧問股份有限公司查核與本獎學金申請之任何有關資料。 5. 本人同意台灣世曦工程顧問股份有限公司得基於獎學金申請、審核等相關作業之目的，於符合個人資料保護相關法令之規定下，為蒐集、處理及使用本人所提供之個人資料。 6. 本人同意本次申請文件作為獎學金查核、審核與核發之依據，且概不退件。	
申請人：_____ (簽名) 中華民國_____年_____月_____日，	

四、證件影本	
請黏貼身分證正面影本	請黏貼身分證反面影本
請黏貼學生證正面影本	請黏貼學生證反面影本
1. 本人茲聲明上述填寫資料及附件資料均屬實，如有不實，願負法律責任。 2. 本人已詳閱台灣世曦工程顧問股份有限公司獎學金辦法，了解本人依本辦法申請獎學金，將於簽訂獎學金契約後負有依約履行之義務，且願意遵守相關規定。 3. 本人切結未受領其他有約定附帶服務義務之獎學金。 4. 本人同意台灣世曦工程顧問股份有限公司查核與本獎學金申請之任何有關資料。 5. 本人同意台灣世曦工程顧問股份有限公司得基於獎學金申請、審核等相關作業之目的，於符合個人資料保護相關法令之規定下，為蒐集、處理及使用本人所提供之個人資料。 6. 本人同意本次申請文件作為獎學金查核、審核與核發之依據，且概不退件。	
申請人：_____ (簽名) 中華民國_____年_____月_____日，	

四、證件影本	
請黏貼身分證正面影本	請黏貼身分證反面影本
請黏貼學生證正面影本	請黏貼學生證反面影本
1. 本人茲聲明上述填寫資料及附件資料均屬實，如有不實，願負法律責任。 2. 本人已詳閱台灣世曦工程顧問股份有限公司獎學金辦法，了解本人依本辦法申請獎學金，將於簽訂獎學金契約後負有依約履行之義務，且願意遵守相關規定。 3. 本人切結未受領其他有約定附帶服務義務之獎學金。 4. 本人同意台灣世曦工程顧問股份有限公司查核與本獎學金申請之任何有關資料。 5. 本人同意台灣世曦工程顧問股份有限公司得基於獎學金申請、審核等相關作業之目的，於符合個人資料保護相關法令之規定下，為蒐集、處理及使用本人所提供之個人資料。 6. 本人同意本次申請文件作為獎學金查核、審核與核發之依據，且概不退件。	
申請人：_____ (簽名) 中華民國_____年_____月_____日，	

四、證件影本

請黏貼身分證正面影本	請黏貼身分證反面影本
請黏貼學生證正面影本	請黏貼學生證反面影本

本人茲聲明上述填寫資料及附件資料均屬實，如有不實，願負法律責任。

本人已詳閱台灣世曦工程顧問股份有限公司獎學金辦法，了解本人依本辦法申請獎學金，將於發給獎學金契約後負有依約履行之義務，且願意遵守相關規定。

本人切結未受領其他有約定附帶服務義務之獎學金。

本人同意台灣世曦工程顧問股份有限公司查核與本獎學金申請之任何有關資料。

本人同意台灣世曦工程顧問股份有限公司得基於獎學金申請、審核等相關作業之目的，於符合個人資料保護相關法令之規定下，為蒐集、處理及使用本人所提供之個人資料。

本人同意本次申請文件作為獎學金查核、審核與核發之依據，且概不退件。

申請人：_____ (簽名) 中華民國_____年_____月_____日

【附件一】

台灣世曦工程顧問股份有限公司獎學金申請表

一、申請人基本資料	
中文姓名：	英文姓名：
身分證字號：	出生年月日：
現就讀學校：	系所/級別：
畢業大學：	科系：
兵役情形： <input type="checkbox"/> 女性免役 <input type="checkbox"/> 已服役 <input type="checkbox"/> 未服役 <input type="checkbox"/> 免役(請附證明)	
戶籍地址：□□□	
通訊地址：□同上□□□	
E-mail：	
電話：	手機：
曾於本公司實習： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 部門：_____ 實習期間：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日	
二、推薦教授	
姓名：	系所戳章
任職學校：	
職稱：	
聯絡電話：	
三、申請文件檢核表	
<input type="checkbox"/> 個人簡歷/自傳 <input type="checkbox"/> 在學證明正本乙份 <input type="checkbox"/> 成績單正本乙份(研究所/大學歷年)	
<input type="checkbox"/> 操行成績(獎懲紀錄) <input type="checkbox"/> 語文能力證明 <input type="checkbox"/> 證書、競賽、專題報告或學術研究等相關資料	
<input type="checkbox"/> 教授推薦信 <input type="checkbox"/> 身分證正反面影本 <input type="checkbox"/> 學生證正反面影本	
<input type="checkbox"/> 其他有利於審查之文件：_____	